

Todos los productos de HIMA nombrados en el presente manual son marcas registradas. Salvo donde se indique lo contrario, esto se aplicará también a los demás fabricantes aquí citados y a sus productos.

Tras haber sido redactadas cuidadosamente, las notas y las especificaciones técnicas ofrecidas en este manual han sido compiladas bajo estrictos controles de calidad. En caso de dudas, consulte directamente a HIMA. HIMA le agradecerá que nos haga saber su opinión acerca de p. ej. qué más información debería incluirse en el manual.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. HIMA se reserva asimismo el derecho de actualizar el material escrito sin previo aviso.

Hallará más información en la documentación recogida en el CD-ROM y en nuestros sitios web http://www.hima.com.

© Copyright 2015, HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Todos los derechos reservados.

Contacto

La dirección de HIMA es: HIMA Paul Hildebrandt GmbH Apdo. Postal / Postfach 1261 D-68777 Brühl

Tel.: +49 6202 709-0 Fax: +49 6202 709-107

Correo electrónico: info@hima.com

Índice de Modificaciones		Tipo de modificación	
revisiones		técnica	redaccional
4.00	Nueva edición del manual de SILworX V4 1ª edición en español	X	X

Índice de contenidos

1	Introducción	5
1.1	Estructuración y uso del manual	5
1.2	Destinatarios	
1.3	Convenciones de representación	6
1.3.1 1.3.2	Notas de seguridad Notas de uso	
2	Seguridad	8
2.1	Uso conforme a la finalidad prevista	8
2.1.1 2.1.2	Condiciones ambientalesPrecauciones contra descargas electrostáticas	
2.2	Peligros remanentes	9
2.3	Medidas de seguridad	9
2.4	Información para emergencias	9
3	Descripción del producto	10
3.1	Función de seguridad	10
3.1.1	Reacción en caso de error	10
3.2	Volumen de suministro	10
3.3	Placa de tipo	11
3.4	Composición	12
3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5	Diagrama de bloques Lectura Indicadores de estado de módulo Indicadores de bus de sistema Indicadores de E/S	13 14 15
3.5	Datos del producto	16
3.6	Tarjetas de conexión	18
3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4	Codificación mecánica de tarjetas de conexión	19 20 21
3.6.5 3.6.6	Asignación de conexiones de tarjetas de conexión con conector de cables Asignación de conectores de tarjetas de conexión con conector de cables	
3.7	Cable de sistema X-CA 001	
3.7.1	Codificación de conectores de cable	26
1	Puesta en carvicio	27

4.1	Montaje	27
4.1.1	Circuitado de las entradas no utilizadas	27
4.2	Instalación y desmontaje del módulo	28
4.2.1	Montaje de una tarjeta de conexión	28
4.2.2	Instalación y desmontaje de un módulo	30
4.3	Registro de eventos (SOE)	32
4.4	Configuración del módulo en SILworX	33
4.4.1	Ficha "Module"	
4.4.2	Ficha I/O Submodule DI32_04	
4.4.3	Ficha I/O Submodule DI32_04: Channels	
4.4.4	Submodule Status [DWORD]	
4.4.5	Diagnostic Status [DWORD]	
4.5	Variantes de conexión	
4.5.1	Puestas en circuito de las entradas	39
4.5.2	Conexión de transmisores mediante terminaciones FTA	
4.5.0	(Field Termination Assembly)	
4.5.3 4.5.4	Protección de Ex con barreras Zener	
_	Protección de Ex con amplificador de separación	
5	Funcionamiento	45
5.1	Manejo	45
5.2	Diagnóstico	45
6	Mantenimiento	46
6.1	Tareas de mantenimiento	46
6.1.1	Carga del sistema operativo	46
6.1.2	Ensayo de prueba	
7	Puesta fuera de servicio	47
8	Transporte	48
9	Desecho	49
	Anexo 50	
	Glosario	50
	Índice de ilustraciones	51
	Índice de tablas	52
	Índice alfabético	53

X-DI 32 04 1 Introducción

1 Introducción

El presente manual describe las características técnicas del módulo y sus posibles usos. El manual contiene información relativa a la instalación, la puesta en servicio y la configuración en SILworX.

1.1 Estructuración y uso del manual

El contenido de este manual es parte de la descripción del hardware del sistema electrónico programable HIMax.

El manual se divide en los siguientes capítulos principales:

- Introducción
- Seguridad
- Descripción del producto
- Puesta en servicio
- Funcionamiento
- Conservación
- Puesta fuera de servicio
- Transporte
- Desecho

Deberán observarse además los siguientes documentos:

Name	Contenido	Documento Nº
Manual del sistema HIMax	Descripción del hardware del sistema HIMax	HI 801 141 ES
Manual de seguridad HIMax	Funciones de seguridad del sistema HIMax	HI 801 196 ES
Manual de comunicación HIMax	Descripción de la comunicación y los protocolos	HI 801 195 ES
Ayuda en pantalla de SILworX (OLH)	Manejo de SILworX	-
Primeros pasos	Introducción al SILworX	HI 801 194 ES

Tabla 1: Manuales vigentes adicionales

Los manuales actuales se hallan en la página web de HIMA: www.hima.com. Con ayuda del índice de revisión del pie de página podrá compararse la vigencia de los manuales que se tengan respecto a la edición que figura en internet.

1.2 Destinatarios

Este documento va dirigido a planificadores, proyectadores y programadores de equipos de automatización y al personal autorizado para la puesta en servicio, operación y mantenimiento de dispositivos y sistemas. Se presuponen conocimientos especiales en materia de sistemas de automatización con funciones relacionadas con la seguridad.

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 5 de 54

1 Introducción X-DI 32 04

1.3 Convenciones de representación

Para una mejor legibilidad y comprensión, en este documento se usa la siguiente notación:

Negrita Remarcado de partes importantes del texto.

Designación de botones de software, fichas e ítems de menús

de SILworX sobre los que puede hacerse clic

Coursiva Variables y parámetros del sistema
Coursier Entradas literales del operador

RUN Designación de estados operativos en mayúsculas

Cap. 1.2.3 Las referencias cruzadas son enlaces, aun cuando no estén

especialmente marcadas como tales. Al colocar el puntero sobre un enlace tal, cambiará su aspecto. Haciendo clic en él, se saltará

a la correspondiente página del documento.

Las notas de seguridad y uso están especialmente identificadas.

1.3.1 Notas de seguridad

Las notas de seguridad del documento se representan de la siguiente forma.

Para garantizar mínimos niveles de riesgo, deberá seguirse sin falta lo que indiquen.

Los contenidos se estructuran en

- Palabra señalizadora: peligro, advertencia, precaución, nota
- Tipo y fuente de peligro
- Consecuencias del peligro
- Prevención del peligro

▲ PALABRA SEÑALIZADORA



¡Tipo y fuente de peligro! Consecuencias del peligro Prevención del peligro

Las palabras señalizadoras significan

- Peligro: su inobservancia originará lesiones graves o mortales
- Advertencia: su inobservancia puede originar lesiones graves o mortales
- Precaución: su inobservancia puede originar lesiones moderadas

NOTA



¡Tipo y fuente del daño! Prevención del daño

Página 6 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

X-DI 32 04 1 Introducción

1.3.2 Notas de uso La información adicional se estructura como sigue: I En este punto figura el texto con la información adicional. Los trucos y consejos útiles aparecen en la forma: SUGERENCIA RENCIA

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 7 de 54

2 Seguridad X-DI 32 04

2 Seguridad

En ningún caso deje sin leer las siguientes informaciones de seguridad, las notas y las instrucciones. Use el producto siempre cumpliendo todas las directivas y las recomendaciones de seguridad.

Este producto se usa con SELV o PELV. El módulo en sí no constituye ninguna fuente de peligro. El uso en áreas explosivas sólo se autoriza si se toman medidas adicionales.

2.1 Uso conforme a la finalidad prevista

Los componentes HIMax van destinados a conformar sistemas de control con función relacionada con la seguridad.

Para hacer uso de estos componentes en sistemas HIMax deberán cumplirse las siguientes condiciones.

2.1.1 Condiciones ambientales

Tipo de condición	Rango de valores
Clase de protección	Clase de protección III según IEC/EN 61131-2
Temperatura ambiente	0+60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+85 °C
Polución	Grado de polución II según IEC/EN 61131-2
Altitud de emplazamiento	< 2000 m
Carcasa	Estándar: IP 20
Tensión de alimentación	24 VCC

Tabla 2: Condiciones ambientales

En condiciones ambientales distintas a las especificadas en este manual es posible que el sistema HIMax sufra disfunciones.

2.1.2 Precauciones contra descargas electrostáticas

Las modificaciones o ampliaciones del sistema, así como la sustitución de módulos, únicamente deberán ser realizas por personal con conocimientos sobre medidas de protección contra descargas electrostáticas.

NOTA



¡Daños en los dispositivos por descarga electrostática!

- Realice estas tareas en un lugar de trabajo antiestático y llevando una cinta de puesta a tierra.
- Guarde bien protegidos (p. ej. en su embalaje original) los dispositivos que no tenga en uso.

Página 8 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

X-DI 32 04 2 Seguridad

2.2 Peligros remanentes

Un módulo HIMax en sí no representa ninguna fuente de peligro.

Lo siguiente puede conllevar peligros remanentes:

- Errores de realización del proyecto
- Errores en el programa de usuario
- Errores en el cableado

2.3 Medidas de seguridad

Respete las normas de seguridad vigentes en el lugar de uso y use la debida indumentaria de seguridad personal.

2.4 Información para emergencias

Un sistema de control HIMax forma parte del equipamiento de seguridad de una planta. Si el sistema de control deja de funcionar, la planta adoptará un estado seguro.

En caso de emergencia está prohibida toda intervención que impida la función de seguridad de los sistemas HIMax.

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 9 de 54

3 Descripción del producto

El módulo digital de entrada X-DI 32 04 sirve para usar en el sistema electrónico programable (PES) de HIMax.

El módulo puede aplicarse en todos los slots del rack, excepto en los slots para los módulos de bus de sistema. Más información en el manual de sistema HI 801 141 ES.

El módulo sirve para evaluar hasta 32 señales de entrada digitales.

El módulo es apto para registro de eventos SOE (Sequence of Events Recording). El registro de eventos se realiza en un ciclo de 1 ms del módulo. Hallará más información en el capítulo 4.3.

El módulo ha sido certificado por el ente de inspección oficial TÜV como apto para aplicaciones hasta el nivel SIL 3 (IEC 61508, IEC 61511 y IEC 62061), Cat. 4 (EN 954-1) y PL e (EN ISO 13849-1).

Las normas aplicadas para la verificación y certificación de los módulos y el sistema HIMax constan en el manual de seguridad HIMax HI 801 196 ES.

3.1 Función de seguridad

El módulo evalúa las señales de entrada digitales y las pone a disposición del programa del usuario.

La función de seguridad responde al nivel SIL 3.

3.1.1 Reacción en caso de error

En caso de error, el módulo adoptará el estado seguro y las variables de entrada asignadas comunicarán el valor inicial (valor predeterminado = 0) al programa del usuario.

Para que, en caso de error, las variables de entrada comuniquen con seguridad el valor 0 al programa del usuario, deberán definirse los valores iniciales como 0.

En todos los casos, el módulo activará el LED Error en el panel frontal.

3.2 Volumen de suministro

Para funcionar el módulo necesita la correspondiente tarjeta de conexión. Si se usa un FTA se necesitará un cable de sistema para conectar la tarjeta de conexión al FTA. Las tarjetas de conexión, el cable de sistema y los FTA no se incluyen en el volumen de suministro del módulo.

Las tarjetas de conexión se describen en el capítulo 3.6, los cables de sistema en el capítulo 3.7 y los FTA en sus respectivos manuales.

Página 10 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

3.3 Placa de tipo

La placa de tipo contiene estos datos importantes:

- Nombre del producto
- Distintivo de homologación
- Código de barras (código 2D o líneas)
- Nº de referencia (Part-No.)
- Índice de revisión del hardware (HW-Rev.)
- Índice de revisión del software (SW-Rev.)
- Tensión de trabajo (Power)
- Especificaciones EX (si procede)
- Año de fabricación (Prod-Year:)



Fig. 1: Ejemplo de placa de tipo

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 11 de 54

3.4 Composición

El módulo está equipado con 32 entradas digitales con función relacionada con la seguridad (24 V) para señales digitales, contactores e iniciadores (a 2 y 3 hilos). Para la detección segura de un nivel High en la entrada digital, deberá sobrepasarse el umbral de corriente y de tensión (ver Tabla 8).

Las ocho alimentaciones (S1+ hasta S8+) a prueba de cortocircuitos proveen a cuatro salidas de alimentación cada una. A cada entrada digital se le ha asignado una salida de alimentación.

El sistema procesador 1002 con función relacionada con la seguridad del módulo de E/S dirige y monitorea el nivel de E/S. Los datos y estados del módulo de E/S se transmiten a los módulos procesadores mediante el bus redundante del sistema. Por razones de disponibilidad, el bus del sistema se implementa de forma redundante. La redundancia sólo estará garantizada cuando ambos módulos de bus de sistema se hayan introducido en el rack y se hayan configurado en SILworX.

Los LED indican el estado de las entradas digitales. Véase el capítulo 3.4.2.

3.4.1 Diagrama de bloques

El siguiente diagrama de bloques muestra la estructura del módulo.

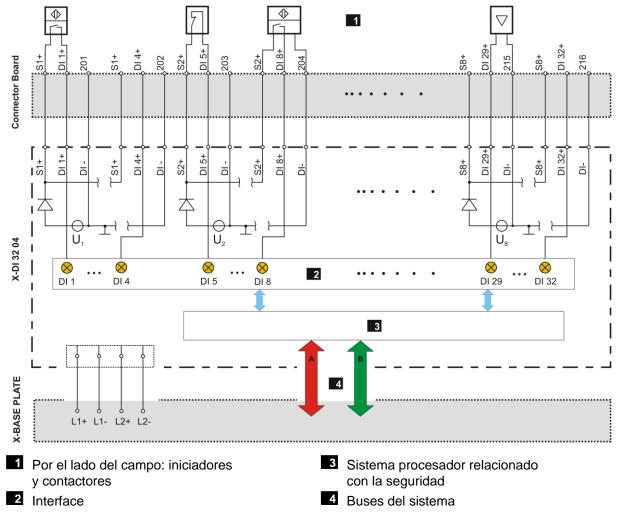


Fig. 2: Diagrama de bloques

Página 12 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

3.4.2 Lectura

La siguiente figura reproduce la lectura del módulo.

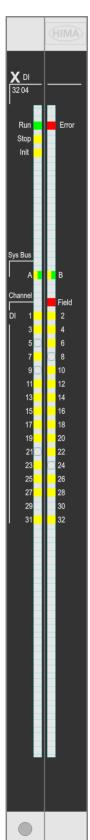


Fig. 3: Lectura

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 13 de 54

Los LED indican el estado operativo del módulo.

Los LED del módulo se dividen en estas categorías:

- Indicadores de estado del módulo (Run, Error, Stop, Init)
- Indicadores de bus de sistema (A, B)
- Indicadores de E/S (DI 1...32, Field)

Al conectarse la tensión de alimentación tendrá lugar siempre una prueba de LEDs, durante la cual se encenderán brevemente todos los LED.

Definición de las frecuencias de parpadeo:

En la siguiente tabla se definen las frecuencias de parpadeo de los LED:

Name	Frecuencia de parpadeo
Parpadeo1	Largo (600 ms) encendido, largo (600 ms) apagado
Parpadeo2	Corto (200 ms) encendido, corto (200 ms) apagado, corto (200 ms) encendido, largo (600 ms) apagado
Parpadeo X	Comunicación Ethernet: Parpadeo sincronizado con la transmisión de datos

Tabla 3: Frecuencias de parpadeo de los LED

3.4.3 Indicadores de estado de módulo

Estos LED se hallan en la parte de arriba de la placa frontal.

LED	Color	Estado	Significado
Run	Verde	Encendido	Módulo en estado RUN, funcionamiento normal
		Parpadeo1	Módulo en estado STOP/OS_DOWNLOAD o RUN/UP STOP (sólo en módulos procesadores)
		Apagado	Módulo no en estado RUN, observar otros LED de estado
Error	Rojo	Encendido/ Parpadeo1	Fallos internos del módulo detectados por la autocomprobación, p. ej. errores de hardware y de software o fallos de la fuente de alimentación. Errores al cargar el sistema operativo
		Apagado	Funcionamiento normal
Stop	Amarillo	Encendido	Módulo en estado STOP/VALID CONFIGURATION
		Parpadeo1	Módulo en estado STOP/INVALID CONFIGURATION o STOP/OS_DOWNLOAD
		Apagado	Módulo no en estado STOP, observar otros LED de estado
Init	Amarillo	Encendido	Módulo en estado INIT
		Parpadeo1	Módulo en estado LOCKED
		Apagado	Módulo no en estado INIT ni LOCKED, observar otros LED de estado

Tabla 4: Indicadores de estado de módulo

Página 14 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

3.4.4 Indicadores de bus de sistema

Los LED indicadores de bus de sistema están rotulados con Sys Bus.

LED	Color	Estado	Significado
А	A Verde Encendido		Conexión física y lógica al módulo de bus de sistema en el slot 1
		Parpadeo1	Sin conexión al módulo de bus de sistema en el slot 1
	Amarillo	Parpadeo1	Conexión física establecida al módulo de bus de sistema en el slot 1
			Sin conexión a un módulo procesador (redundante) en el funcionamiento del sistema
В	Verde	Encendido	Conexión física y lógica al módulo de bus de sistema en el slot 2
		Parpadeo1	Sin conexión al módulo de bus de sistema en el slot 2
	Amarillo	Parpadeo1	Conexión física establecida al módulo de bus de sistema en el slot 2 Sin conexión a un módulo procesador (redundante) en el funcionamiento del sistema
A+B	Apagado	Apagado	Sin conexión física ni lógica a los módulos del bus del sistema en los slots 1 y 2.

Tabla 5: Indicadores de bus de sistema

3.4.5 Indicadores de E/S

Los LED que indican las E/S están rotulados con Channel.

LED	Color	Estado	Significado
Channel	Amarillo	Encendido	Nivel High aplicado
132		Parpadeo2	Error de canal
		Apagado	Nivel Low aplicado
Field	Rojo	Parpadeo2	Error de campo en al menos un canal o una alimentación
		Apagado	Sin errores en campo

Tabla 6: LED indicadores de E/S

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 15 de 54

3.5 Datos del producto

Generalidades	Generalidades			
Tensión de alimentación	24 VCC, -15%+20%, w _s ≤ 5%, SELV, PELV			
Amperaje	mín. 400 mA (sin alimentaciones/canales) máx. 1,5 A (en caso de cortocircuito de las alimentaciones)			
Amperaje por canal	mín. < 1 mA (sin alimentación) máx. 25 mA (con alimentación)			
Temperatura de trabajo	0 °C+60 °C			
Temperatura de almacenamiento	-40 °C+85 °C			
Humedad	máx. 95% de humedad relativa, sin rocío			
Grado de protección	IP 20			
Dimensiones (H x A x Prof) en mm	310 x 29,2 x 230			
Masa	aprox. 1,0 kg			

Tabla 7: Datos del producto

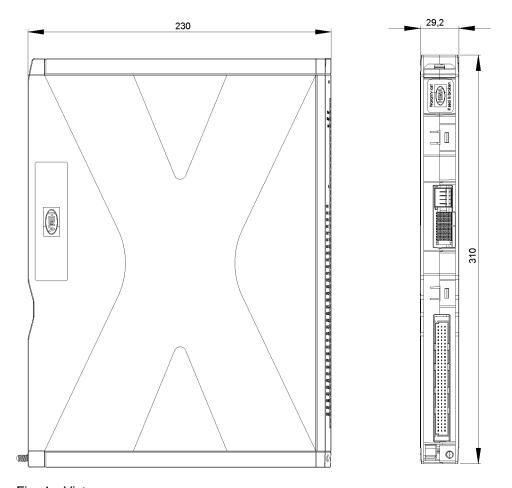


Fig. 4: Vistas

Página 16 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

Entradas digitales		
Cantidad de entradas (número de canales)	32 unipolar con polo de referencia DI-/ L-, no separadas galvánicamente entre sí	
Tipo de entrada	Consumidora de corriente, 24 V, tipo 3 según IEC 61131-2	
Tensión de entrada nominal	024 V	
Rango útil de la tensión de entrada	-330 V	
Rango de tensiones de nivel Low	-35 V	
Rango de tensiones de nivel High	1130 V	
Punto de conmutación	$tip. 9,4 V \pm 0,8 V (2,1 mA \pm 0,3 mA)$	
Ciclo de registro de eventos (SOE)	1 ms	
Renovación del valor de medición (en el programa del usuario)	Tiempo de ciclo del programa del usuario	

Tabla 8: Datos técnicos de las entradas digitales

Alimentación			
Cantidad de alimentaciones	8 con 4 salidas cada una		
Tensión de salida de alimentación	Tensión de alimentación -2,5 V		
Intensidad de salida de alimentación	100 mA por grupo a prueba de cortocircuitos		
Detección de subtensión	El módulo monitorea si hay subtensión en las alimentaciones (< 16 VCC). En caso de error, hará que el correspondiente estado Supply X OK cambie a FALSE.		
Cortocircuito de una alimentación	La detección de subtensión actúa. La intensidad de salida pulsará a < 250 mA mientras la alimentación esté cortocircuitada.		
Asignación de las salidas de alimentación			
Para la alimentación deberá usarse la salida de tensión respectivamente asignada a la entrada.			
Alimentación S1+	DI1+DI4+		
Alimentación S2+	DI5+DI8+		
Alimentación S3+	DI9+DI12+		
Alimentación S4+	DI13+DI16+		
Alimentación S5+	DI17+DI20+		
Alimentación S6+	DI21+DI24+		
Alimentación S7+	DI25+DI28+		
Alimentación S8+	DI29+DI32+		

Tabla 9: Datos técnicos de alimentación

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 17 de 54

3.6 Tarjetas de conexión

Una tarjeta de conexión conecta el módulo al nivel de campo. Módulo y tarjeta de conexión conforman juntos una unidad funcional. Antes de instalar el módulo, monte la tarjeta de conexión en el slot previsto.

Para el módulo se dispone de las siguientes tarjetas de conexión:

Tarjeta de conexión	Descripción			
X-CB 015 01	Tarjeta de conexión con bornes de rosca			
X-CB 015 02	Tarjeta de conexión redundante con bornes de rosca			
X-CB 015 03	Tarjeta de conexión con conector de cables			
X-CB 015 04	Tarjeta de conexión redundante con conector de cables			
X-CB 015 06	Tarjeta de conexión triplemente redundante con bornes de rosca			
X-CB 015 07	Tarjeta de conexión triplemente redundante con conector de cables			
X-CB 004 01 1)	Tarjeta de conexión con bornes de rosca			
X-CB 004 02 1)	Tarjeta de conexión redundante con bornes de rosca			
X-CB 004 03 1) Tarjeta de conexión con conector de cables				
X-CB 004 04 1)	Tarjeta de conexión redundante con conector de cables			
X-CB 004 06 1)	Tarjeta de conexión triplemente redundante con bornes de rosca			
X-CB 004 07 1)	Tarjeta de conexión triplemente redundante con conector de cables			
1) Reemplazada por X-CB 015				

Tabla 10: Tarjetas de conexión disponibles

3.6.1 Codificación mecánica de tarjetas de conexión

Los módulos de E/S y las tarjetas de conexión están mecánicamente codificados a partir de la versión AS 10 del hardware, para evitar el montaje de módulos de E/S inadecuados. La codificación impide montar elementos equivocados y evita así repercusiones sobre el campo y módulos redundantes. Además, el montaje de elementos equivocados no afecta en absoluto al sistema HIMax, ya que sólo los módulos correctamente configurados en SILworX adoptarán el estado RUN.

Los módulos de E/S y sus correspondientes tarjetas de conexión están dotados de una codificación mecánica en forma de cuñas. Las cuñas de codificación de la regleta de resorte de la tarjeta de conexión encajan en las escotaduras de la regleta del conector del módulo de E/S, véase Fig. 5.

Los módulos de E/S codificados sólo encajarán en las tarjetas de conexión correspondientes.

Página 18 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

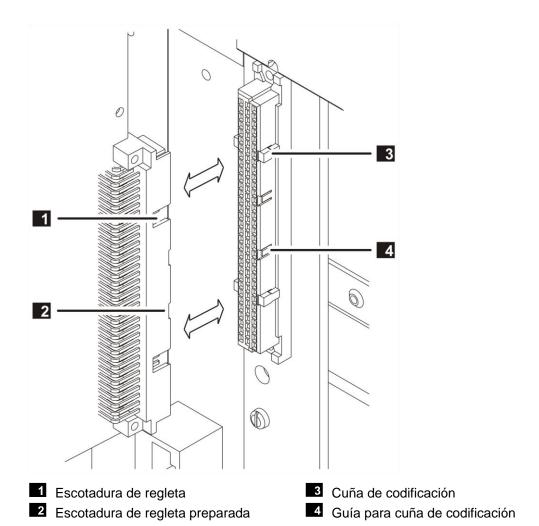


Fig. 5: Ejemplo de una codificación

Los módulos de E/S codificados encajarán también en tarjetas de conexión sin codificar. Los módulos de E/S no codificados no encajarán en tarjetas de conexión codificadas.

3.6.2 Codificación de tarjetas de conexión X-CB 015

a7	a13	a20	a26	с7	c13	c20	c26
Χ	X	Χ	Χ				

Tabla 11: Posición de las cuñas de codificación

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 19 de 54

3.6.3 Tarjetas de conexión con bornes de rosca

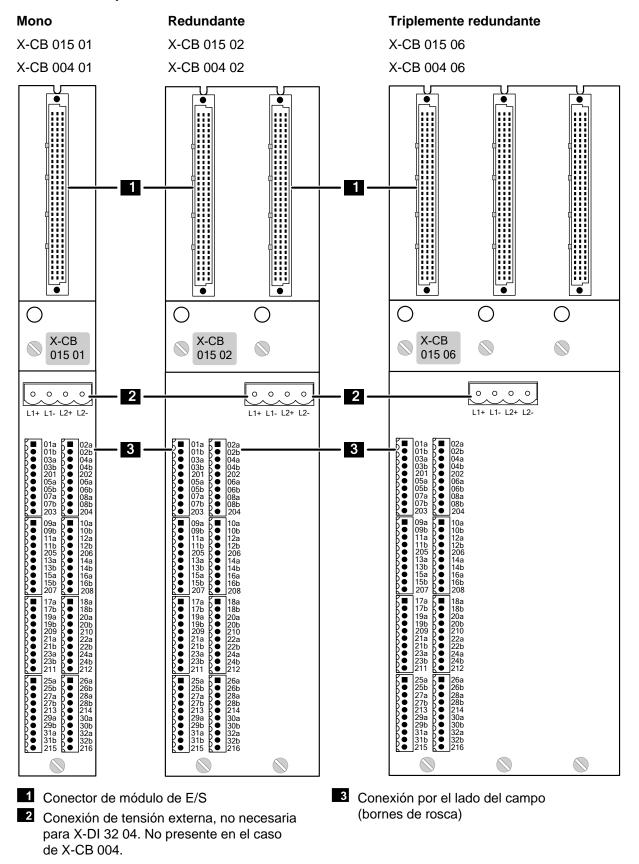


Fig. 6: Tarjetas de conexión X-CB 015 con bornes de rosca

Página 20 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

3.6.4 Asignación de bornes de tarjetas de conexión con bornes de rosca

Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal	
1	01a	S1+	1	02a	S1+	
2	01b	DI1+	2	02b	DI2+	
3	03a	S1+	3	04a	S1+	
4	03b	DI3+	4	04b	DI4+	
5	201 ¹⁾	DI-	5	202 ¹⁾	DI-	
6	05a	S2+	6	06a	S2+	
7	05b	DI5+	7	06b	DI6+	
8	07a	S2+	8	08a	S2+	
9	07b	DI7+	9	08b	DI8+	
10	203 ¹⁾	DI-	10	204 ¹⁾	DI-	
Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal	
1	09a	S3+	1	10a	S3+	
2	09b	DI9+	2	10b	DI10+	
3	11a	S3+	3	12a	S3+	
4	11b	DI11+	4	12b	DI12+	
5	205 ¹⁾	DI-	5	206 ¹⁾	DI-	
6	13a	S4+	6	14a	S4+	
7	13b	DI13+	7	14b	DI14+	
8	15a	S4+	8	16a	S4+	
9	15b	DI15+	9	16b	DI16+	
10	207 ¹⁾	DI-	10	208 ¹⁾	DI-	
Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal	
1	17a	S5+	1	18a	S5+	
2	17b	DI17+	2	18b	DI18+	
3	19a	S5+	3	20a	S5+	
4	19b	DI19+	4	20b	DI20+	
5	209 ¹⁾	DI-	5	210 ¹⁾	DI-	
6	21a	S6+	6	22a	S6+	
7	21b	DI21+	7	22b	DI22+	
8	23a	S6+	8	24a	S6+	
9	23b	DI23+	9	24b	DI24+	
10	211 ¹⁾	DI-	10	212 ¹⁾	DI-	
Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal	
1	25a	S7+	1	26a	S7+	
2	25b	DI25+	2	26b	DI26+	
3	27a	S7+	3	28a	S7+	
4	27b	DI27+	4	28b	DI28+	
5	213 ¹⁾	DI-	5	214 ¹⁾	DI-	
6	29a	S8+	6	30a	S8+	
7	29b	DI29+	7	30b	DI30+	
8	31a	S8+	8	32a	S8+	
9	31b	DI31+	9	32b	DI 32+	
10	215 ¹⁾	DI-	10	216 ¹⁾	DI-	
¹⁾ En las tarjetas de conexión X-CB 004 01/02/06 estos bornes se designan con <i>DI</i>						

Tabla 12: Asignación de bornes de tarjetas de conexión con bornes de rosca

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 21 de 54

La conexión por el lado del campo y la alimentación externa se realiza con conectores de bornes que se conectan a las regletas de pins de las tarjetas de conexión.

Los conectores de bornes tienen las siguientes características:

Conexión por el lado del campo				
Conectores de bornes	8 unidades, de 10 polos			
Sección transversal de cable	0,21,5 mm² (monohilo) 0,21,5 mm² (de hilo fino)			
	0,21,5 mm² (con puntera terminal)			
Longitud de pelado	6 mm			
Destornillador	Ranura 0,4 x 2,5 mm			
Par de apriete	r de apriete 0,20,25 Nm			
Fuente de alimentación externa				
Conectores de bornes	de 4 polos			
Sección transversal	0,22,5 mm² (monohilo)			
de cable	0,22,5 mm ² (de hilo fino)			
	0,252,5 mm² (con puntera terminal)			
Longitud de pelado 7 mm				
Destornillador Ranura 0,6 x 3,5 mm				
Par de apriete 0,50,6 Nm				

Tabla 13: Características de los conectores de bornes

Página 22 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

3.6.5 Asignación de conexiones de tarjetas de conexión con conector de cables

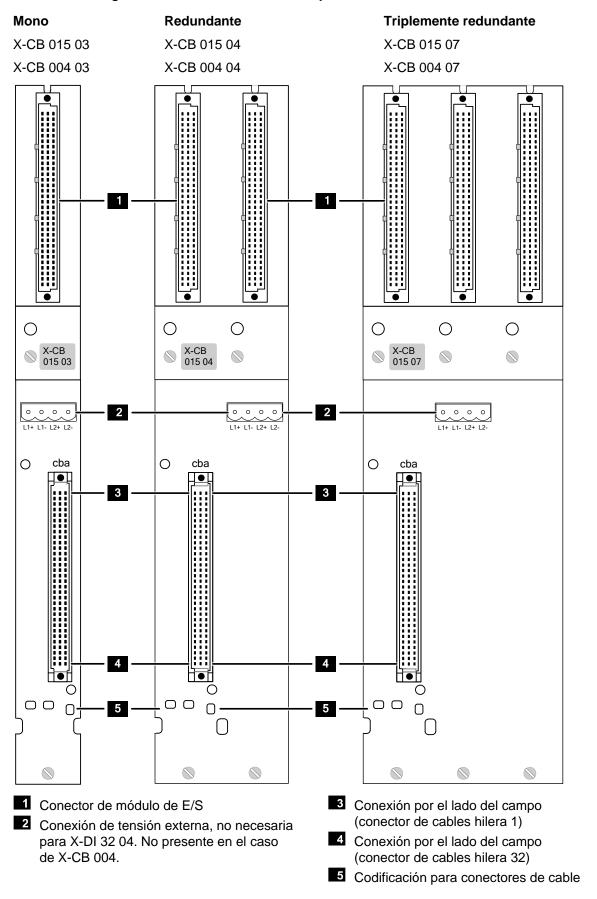


Fig. 7: Tarjetas de conexión X-CB 015 con conector de cables

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 23 de 54

3.6.6 Asignación de conectores de tarjetas de conexión con conector de cables Para estas tarjetas de conexión, HIMA ofrece cables de sistema preconfeccionados. Véase el capítulo 3.7. Tarjetas de conexión y conectores de cables están codificados.

Asignación de conectores

La siguiente tabla describe la asignación de conectores del cable del sistema.

Designación de hilos conforme a DIN 47100:

Hilera	c c		b		а	а	
Піівіа	Señal	Color	Señal	Color	Señal	Color	
1			DI32+	ye-bu	reservado	rd 1)	
2			DI31+	gn-bu	reservado	bu ¹⁾	
3			DI30+	ye-pk	reservado	pk 1)	
4			DI29+	pk-gn	reservado	gy 1)	
5			DI28+	ye-gy			
6			DI27+	gy-gn			
7			DI26+	bn-bk			
8			DI25+	wh-bk			
9			DI24+	bn-rd			
10			DI23+	wh-rd			
11			DI22+	bn-bu			
12			DI21+	wh-bu			
13			DI20+	pk-bn			
14			DI19+	wh-pk			
15			DI18+	gy-bn			
16			DI17+	wh-gy			
17			DI16+	ye-bn	DI-	ye 1)	
18			DI15+	wh-ye	DI-	gn ¹⁾	
19			DI14+	bn-gn	DI-	bn 1)	
20			DI13+	wh-gn	DI-	wh 1)	
21			DI12+	rd-bu	DI-	rd-bk	
22			DI11+	gy-pk	DI-	bu-bk	
23			DI10+	vt	DI-	pk-bk	
24			DI9+	bk	DI-	gy-bk	
25			DI8+	rd	S8+	pk-rd	
26			DI7+	bu	S7+	gy-rd	
27			DI6+	pk	S6+	pk-bu	
28			DI5+	gy	S5+	gy-bu	
29			DI4+	ye	S4+	ye-bk	
30			DI3+	gn	S3+	gn-bk	
31			DI2+	bn	S2+	ye-rd	
32			DI1+	wh	S1+	gn-rd	
1) Anillo a	dicional nara	anja en caso d	de repetirse el	color de la de	esignación de h	ilos.	

Tabla 14: Asignación de conectores de tarjetas de conexión con conector de cables

La conexión desde la fuente de alimentación externa se realiza mediante un conector de bornes extraíble de 4 polos. Las características del conector de bornes se describen en la Tabla 13.

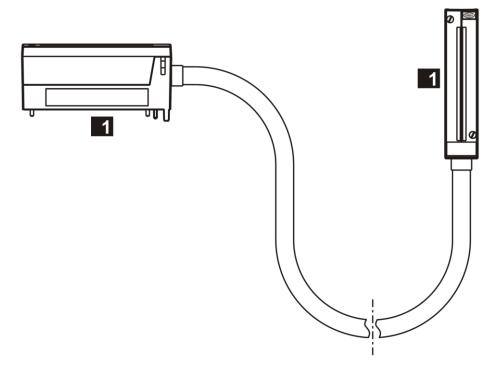
Página 24 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

3.7 Cable de sistema X-CA 001

El cable del sistema X-CA 001 conecta las tarjetas de conexión X-CB 004 03/04/07 y X-CB 015 03/04/07 a las terminaciones de campo (FTA).

Generalidades	
Cable	LIYY-TP 38 x 2 x 0,25 mm ²
Conductor	De hilo fino
Diámetro exterior medio (d)	aprox. 15,2 mm
Mínimo radio de curvatura	
Tendido fijo	5 x d
Tendido móvil	10 x d
Respuesta frente al fuego	Resistente a llama y autoextinguible conforme a IEC 60332-1-2, -2-2
Longitud	830 m
Codificación por colores	Conforme a DIN 47100, véase Tabla 14.

Tabla 15: Datos de cables



1 Conectores de cable idénticos

Fig. 8: Cable de sistema X-CA 001 01 n

El cable del sistema puede suministrarse en las siguientes variantes estándar:

Cable del sistema	Descripción	Longitud
X-CA 001 01 8	Conectores de cables codificados a ambos lados.	8 m
X-CA 001 01 15		15 m
X-CA 001 01 30		30 m

Tabla 16: Cables de sistema disponibles

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 25 de 54

3.7.1 Codificación de conectores de cable

Los conectores de cables tienen tres clavijas de codificación. Así, los conectores podrán conectarse únicamente a tarjetas de conexión y FTAs con la correspondiente codificación. Véase Fig. 7.

Página 26 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

X-DI 32 04 4 Puesta en servicio

4 Puesta en servicio

En este capítulo se describe cómo se instala y configura el módulo, así como sus variantes de conexión. Hallará más información en el manual de seguridad de HIMax HI 801 196 ES.

La aplicación relacionada con la seguridad (SIL 3 según IEC 61508) de las entradas (incluidos los iniciadores conectados a ellas) deberá cumplir las exigencias normativas de seguridad. Más información en el manual de seguridad de HIMax.

4.1 Montaje

Para el montaje observe los siguientes puntos:

- Para usar sólo con los correspondientes componentes de ventilación, véase el manual HI 801 141 ES.
- Para usar sólo con la correspondiente tarjeta de conexión. Véase el capítulo 3.6.
- El módulo, incluidos sus elementos de conexión, habrá de montarse de tal manera que se tenga por lo menos el grado de protección IP 20 según EN 60529: 1991 + A1:2000.

NOTA



¡Daños por conexión incorrecta del circuito! La inobservancia puede dar lugar a daños en elementos electrónicos. Observe los siguientes puntos.

- Bornes y conectores por el lado del campo
 - Al conectar bornes y conectores al lado del campo, preste atención a una puesta a tierra adecuada.
 - Para conectar los iniciadores y los contactos de conmutación a las entradas digitales se admite usar un cable no apantallado.
 - Por la parte del módulo tienda el apantallado en el carril de apantallado de cables (use borne de conexión de apantallado SK 20 o equivalente).
 - En el caso de los conductores de varios hilos, HIMA recomienda dotar a los extremos del conductor con punteras terminales. Los bornes de conexión deberán ser aptos para los bornes secundarios de las secciones transversales empleadas.
- Si se emplea la alimentación, use la salida de tensión respectivamente asignada a la entrada. Véase Tabla 9.
- HIMA recomienda usar la alimentación del módulo. En caso de disfunciones de una unidad externa de alimentación o medición, es posible que la entrada digital afectada del módulo sufra sobrecargas y daños. Si es necesaria la alimentación externa, compruebe los umbrales de conmutación seguido a una sobrecarga no transitoria por encima de los valores máximos del módulo.
- Implemente el circuitado redundante de las entradas mediante las correspondientes tarjetas de conexión. Véase el capítulo 3.6 y 4.5.

4.1.1 Circuitado de las entradas no utilizadas

Las entradas no utilizadas podrán dejarse abiertas, no es necesario usar terminaciones. Sin embargo, para evitar cortocircuitos no se permitirá conectar a las tarjetas de conexión conductores que tengan extremos abiertos por el lado del campo.

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 27 de 54

4 Puesta en servicio X-DI 32 04

4.2 Instalación y desmontaje del módulo

En este capítulo se describe cómo sustituir un módulo existente o colocar un módulo nuevo.

Al retirar el módulo, la tarjeta de conexión permanecerá en el rack HIMax. Esto evita trabajos de cableado adicionales en los bornes de conexión, ya que todas las conexiones de campo se realizan mediante la tarjeta de conexión del módulo.

4.2.1 Montaje de una tarjeta de conexión

Herramientas y medios auxiliares

- Destornillador, ranura de 0,8 x 4,0 mm
- Tarjeta de conexión adecuada

Montaje de la tarjeta de conexión:

- Introduzca la tarjeta de conexión en el carril guía con la ranura hacia arriba (véase al respecto el siguiente dibujo). Encaje la ranura en la espiga del carril guía.
- 2. Emplace la tarjeta de conexión sobre el carril de apantallado de cables.
- 3. Atorníllela al rack con los dos tornillos imperdibles. Primero enrosque el tornillo inferior y luego el superior.

Desmontaje de la tarjeta de conexión:

- 1. Destornille los tornillos imperdibles del rack.
- 2. Separe la tarjeta de conexión por abajo del carril de apantallado.
- 3. Saque la tarjeta de conexión del carril guía.

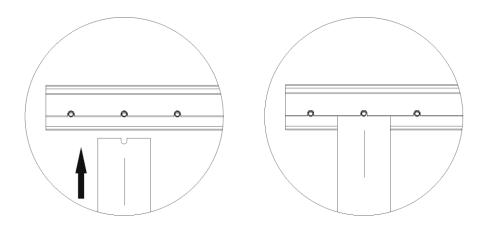


Fig. 9: Colocación de la tarjeta de conexión

Página 28 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

X-DI 32 04 4 Puesta en servicio

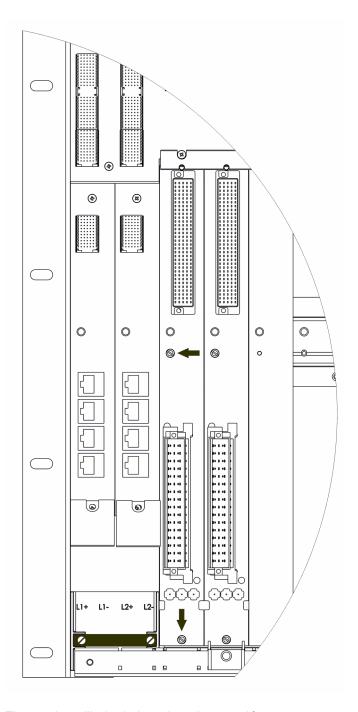


Fig. 10: Atornillado de la tarjeta de conexión

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 29 de 54

4 Puesta en servicio X-DI 32 04

4.2.2 Instalación y desmontaje de un módulo

Este capítulo describe cómo se instala y retira un módulo HIMax. Un módulo podrá instalarse y retirarse sin interrumpir el funcionamiento del sistema HIMax.

NOTA



¡Daños de los conectores en caso de introducirlos ladeados! La inobservancia puede dar lugar a daños en el sistema de control. Coloque los módulos siempre con cuidado en su rack.

Herramientas

- Destornillador, ranura de 0,8 x 4,0 mm
- Destornillador, ranura de 1,2 x 8,0 mm

Instalación

- 1. Abra la chapa de cierre del rack del ventilador:
 - ☑ Ponga los bloqueos en posición abierta
 - ☑ Gire la chapa de cierre hacia arriba e introdúzcala en el rack del ventilador
- 2. Coloque el módulo en la parte superior del perfil de suspensión, véase 1.
- Gire el módulo en la parte inferior en la rack y encástrelo con una ligera presión, véase 2.
- 4. Atornille el módulo, véase 3.
- 5. Saque la chapa de cierre hacia arriba del rack del ventilador y gírela hacia abajo.
- 6. Bloquee la chapa de cierre.

Desmontaje

- 1. Abra la chapa de cierre del rack del ventilador:
 - ☑ Ponga los bloqueos en posición abierta
 - ☑ Gire la chapa de cierre hacia arriba e introdúzcala en el rack del ventilador
- 2. Suelte el tornillo, véase 3.
- 3. Gire el módulo para sacarlo de la parte inferior en la rack y desencájelo con una ligera presión hacia arriba del perfil, véase 2 y 1.
- 4. Saque la chapa de cierre hacia arriba del rack del ventilador y gírela hacia abajo.
- 5. Bloquee la chapa de cierre.

Página 30 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

X-DI 32 04 4 Puesta en servicio

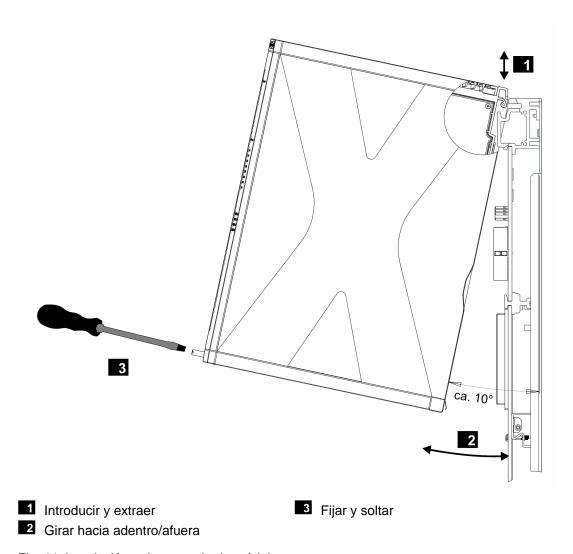


Fig. 11: Instalación y desmontaje de módulo

Durante el funcionamiento del sistema HIMax tenga abierta la chapa de cierre del rack del ventilador brevemente (< 10 min.), pues ello menoscaba la convección forzada.

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 31 de 54

4 Puesta en servicio X-DI 32 04

4.3 Registro de eventos (SOE)

Es posible el registro de eventos para todas las entradas digitales del módulo. Las entradas a monitorear se configuran con ayuda de la utilidad de programación SILworX. Véase la ayuda directa en pantalla y el manual de comunicación HI 801 195 ES.

El módulo de E/S lee, en cada uno de sus ciclos (1 ms) los valores de medición de las entradas digitales y genera eventos que se guardan en el búfer volátil de eventos de E/S.

Un evento consta de:

Evento	Descripción		
ID de evento	El ID de evento lo asigna el PADT.		
Marca de tiempo	Fecha (p. ej.: 21.11.2008)		
	Hora (p. ej.: 9:31:57.531)		
Estado del evento	Alarma/Normal		
Calidad del evento	Quality good/		
	Quality bad, véase www.opcfoundation.org		

Tabla 17: Descripción de eventos

El módulo procesador lee los eventos cíclicamente desde el búfer de eventos de E/S y los guarda en su memoria no volátil. Los eventos leídos por el módulo procesador podrán entonces ser sobrescritos por otros nuevos en el búfer de eventos de E/S.

En caso de llenarse el búfer de eventos de E/S, el módulo de E/S generará un registro de evento de sistema de desborde en la memoria no volátil del módulo procesador. A continuación no se generarán más eventos hasta que vuelva a haber lugar en el búfer por haber sido leído éste de nuevo.

Página 32 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

X-DI 32 04 4 Puesta en servicio

4.4 Configuración del módulo en SILworX

El módulo se configura en el editor de hardware de la utilidad de programación SILworX.

Para la configuración observe los siguientes puntos:

- Para el diagnóstico del módulo y de los canales podrán usarse en el programa del usuario los parámetros del sistema además del valor de medición. Hallará más información sobre los parámetros del sistema en las tablas a partir del capítulo 4.4.1.
- La alimentación de un canal se monitorea. Si está activo el parámetro Supply used, una alimentación errónea dará lugar a un error de canal (-> Channel OK = FALSE). Si no se usa la alimentación de un canal, habrá que desactivar el parámetro Supply used. Así, un error de alimentación no dará lugar a un error de canal (-> Channel OK = TRUE). Para diagnosticar la alimentación utilizada, podrá evaluarse el estado Supply X OK en el programa del usuario. Hallará más información sobre el estado Supply X OK en la Tabla 19.
- Si se crea un grupo de redundancia, éste se configurará en sus fichas. Las fichas del grupo de redundancia son diferentes de las de los módulos individuales. Véanse las tablas subsiguientes.

Para poder evaluar los parámetros del sistema en el programa del usuario, deberán asignarse variables globales a los parámetros del sistema. Realice este paso dentro del editor de hardware en la vista en detalle del módulo.

Las tablas subsiguientes contienen los parámetros de sistema del módulo en el mismo orden que en el editor de hardware de SILworX.

SUGE-

Para convertir los valores hexadecimales en secuencias de bits puede usarse **RENCIA** p. ej. la calculadora de Windows[®] en su formato "científico".

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 33 de 54 4 Puesta en servicio X-DI 32 04

4.4.1 Ficha "Module"

La ficha **Module** contiene los siguientes parámetros de sistema del módulo:

Name		R/W	Descripción		
Estos estados y pai	rámetros se	escriben	directamente en el editor de hardware.		
Name		W	Nombre del módulo		
Spare Module W		W	Activado: la ausencia de un módulo del grupo de redundanci en el rack no se evaluará como error. Desactivado: la ausencia de un módulo del grupo de redundancia en el rack se evaluará como error. Configuración por defecto: Desactivado ¡Aparece sólo en la ficha del grupo de redundancia!		
Noise Blanking		W	Admitir inhibición de fallos por parte del módulo procesador (activado/desactivado). Configuración por defecto: Activado El módulo procesador demora la reacción a error frente a una perturbación transitoria hasta el tiempo de seguridad.		
			Seguirá obrando el último valor de proceso válido para el programa del usuario.		
Name	Tipo de datos	R/W	Descripción		
del usuario.			drán asignarse a variables globales y utilizarse en el programa		
Module OK	BOOL	R	TRUE: Modo mono: sin errores de módulo Modo en redundancia: al menos uno de los módulos redundantes no tiene un error de módulo (lógica "OR"). FALSE: Error de módulo Error de canal de un canal (no errores externos) Módulo no introducido.		
			Observe el parámetro Module Status.		
Module Status	DWORD	R	Estado del módulo		
			Codificación Descripción		
			0x00000001 Error del módulo 1) 0x00000002 Umbral de temperatura 1 excedido 0x00000004 Umbral de temperatura 2 excedido 0x00000008 Valor de temperatura erróneo 0x00000010 Tensión L1+ errónea 0x00000020 Tensión L2+ errónea 0x00000040 Tensiones internas erróneas		
			0x80000000 Sin conexión al módulo 1)		
			1) Estos errores tienen repercusiones sobre el estado Module OK y no es necesario evaluarlos explícitamente en el programa del usuario.		
Timestamp [µs]	DWORD	R	Parte en microsegundos de la marca de tiempo. Momento de la medición de las entradas digitales.		
Timestamp [s]	DWORD	R	Parte en segundos de la marca de tiempo. Momento de la medición de las entradas digitales.		

Tabla 18: Ficha Module del editor de hardware

Página 34 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

X-DI 32 04 4 Puesta en servicio

4.4.2 Ficha I/O Submodule DI32_04

La ficha I/O Submodule DI32_04 contiene los siguientes parámetros del sistema:

Name		R/W	Descripción			
No será posible modificar este parámetro.						
Name		R	Nombre del módulo			
Name	Tipo de datos	R/W	Descripción			
Los siguientes estados y del usuario.	/ parámetros	s podrá	n asignarse a variables globales y utilizarse en el programa			
Diagnostic Request	DINT	W	Para solicitar un valor de diagnóstico, deberá enviarse al módulo el correspondiente ID (ver codificación en 4.4.5) mediante el parámetro <i>Diagnostic Request</i> .			
Diagnostic Response	DINT	R	Una vez que <i>Diagnostic Response</i> devuelva el ID (ver codificación en 4.4.5) de <i>Diagnostic Request</i> , en <i>Diagnostic Status</i> se tendrá el valor de diagnóstico solicitado.			
Diagnostic Status	DINT	R	Valor de diagnóstico solicitado conforme a <i>Diagnostic</i> Response. En el programa del usuario se podrán evaluar los ID de <i>Diagnostic Request</i> y de <i>Diagnostic Response</i> . Sólo cuando ambos contengan el mismo ID, contendrá Diagnostic Status el valor de diagnóstico solicitado.			
Background Test Error	BOOL	R	TRUE: Prueba en segundo plano errónea FALSE: Prueba en segundo plano exenta de errores			
Restart on Error	BOOL	W	Todo módulo de E/S que esté desactivado prolongadamente a causa de errores podrá ponerse de nuevo en estado RUN mediante el parámetro Restart on Error. Para ello cambie el parámetro Restart on Error de FALSE a TRUE. El módulo de E/S realizará una autocomprobación completa y adoptará el estado RUN si no detecta ningún error. Configuración por defecto: FALSE			
Supply 1 OK	BOOL	R	Se monitorea si hay subtensión en las alimentaciones. TRUE: Alimentación exenta de errores. FALSE: Alimentación errónea.			
Supply 2 OK	BOOL	R	Igual que <i>Supply 1 OK</i>			
Supply 3 OK	BOOL	R	Igual que <i>Supply 1 OK</i>			
Supply 4 OK	BOOL	R	Igual que <i>Supply 1 OK</i>			
Supply 5 OK	BOOL	R	Igual que <i>Supply 1 OK</i>			
Supply 6 OK	BOOL	R	Igual que <i>Supply 1 OK</i>			
Supply 7 OK	BOOL	R	Igual que <i>Supply 1 OK</i>			
Supply 8 OK	BOOL	R	Igual que <i>Supply 1 OK</i>			
Submodule OK	BOOL	R	TRUE: Sin errores de submódulo Sin errores de canal FALSE: Error de submódulo Error de canal (también errores externos) de un canal			
Submodule Status	DWORD	R	Estado del submódulo codificado en bits (ver codificación en 4.4.4)			

Tabla 19: Ficha I/O Submodule DI32_04 del editor de hardware

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 35 de 54

4 Puesta en servicio X-DI 32 04

4.4.3 Ficha I/O Submodule DI32_04: Channels

La ficha **I/O Submodule DI32_04: Channels** contiene los siguientes parámetros de sistema para cada entrada digital.

A los parámetros de sistema con -> pueden asignárseles variables globales y utilizarse en el programa del usuario. Los valores sin -> deberá Ud. escribirlos directamente.

Name	Tipo de datos	R/W	Descripción
Channel No.		R	Nº de canal, predefinido por defecto
-> Channel Value [BOOL]	BOOL	R	Valor booleano de la entrada digital, LOW o HIGH
-> Channel OK	BOOL	R	TRUE: Canal exento de errores. El valor de entrada será válido. FALSE: Canal erróneo. El valor de entrada cambiará a FALSE.
Ton [µs]	UDINT	W	Retardo de conexión El módulo indicará un cambio de nivel de LOW a HIGH sólo cuando el nivel High esté presente más que el tiempo parametrizado como t _{on} . Atención: El máximo tiempo de reacción T _R (worst case) se prolongará para ese canal en el retardo aquí elegido, ya que un cambio de nivel se reconocerá como tal sólo tras transcurrir el tiempo de retardo. Rango de valores: 0(2 ³² - 1) Configuración por defecto: 0
Toff [µs]	UDINT	W	Retardo de desconexión El módulo indicará un cambio de nivel de HIGH a LOW sólo cuando el nivel Low esté presente más que el tiempo parametrizado como t _{off} . Atención: El máximo tiempo de reacción T _R (worst case) se prolongará para ese canal en el retardo aquí elegido, ya que un cambio de nivel se reconocerá como tal sólo tras transcurrir el tiempo de retardo. Rango de valores: 0(2 ³² - 1) Configuración por defecto: 0
Sup. used	BOOL	W	Activado: Se usa la alimentación. Desactivado: No se usa la alimentación. Configuración por defecto: Activado
Redund.	BOOL	W	Requisitos: deberá haber creado un módulo redundante. Activado: activación de la redundancia de canal para ese canal Desactivado: desactivación de la redundancia de canal para ese canal Configuración por defecto: Desactivado
Redundancy value	BYTE	W	Definición de cómo se forma el valor de redundancia. AND OR Configuración por defecto: OR ¡Aparece sólo en la ficha del grupo de redundancia!

Tabla 20: Ficha I/O Submodule D32_04: Canales en el editor de hardware

Página 36 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

4.4.4 Submodule Status [DWORD]

Codificación de la variable Submodule Status.

Codificación	Descripción
0x0000001	Error de la unidad de hardware (submódulo)
0x00000002	Reset de un bus de E/S
0x00800000	Error de módulo, tensión de referencia A
0x01000000	Error, tensión de referencia A (sobretensión)
0x02000000	Error, tensión de referencia B (subtensión)
0x04000000	Error de módulo, tensión de referencia B
0x0800000	Error de tensión auxiliar
0x10000000	Error, tensión de referencia A (subtensión)
0x20000000	Error, tensión de referencia B (sobretensión)
0x40000000	Error de monitoreo A de selección de chip
0x80000000	Error de monitoreo B de selección de chip

Tabla 21: Submodule Status [DWORD]

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 37 de 54

4.4.5 Diagnostic Status [DWORD]

Codificación de la variable **Diagnostic Status**.

ID	Descripción			
0	Los valores de diagnóstico (1002008) se mostrarán consecutivamente.			
100	Estado de temperatura codificado en bits 0 = normal			
	Bit0 = 1 : Umbral de temperatura 1 excedido			
	Bit1 = 1 : Umbral de temperatura 2 excedido			
	Bit2 = 1 : medición de temperatura errónea			
101	temperatura medida (10 000 dígitos/°C)			
200		ión codificado en bits		
	0 = normal			
	Bit0 = 1 : L1+ (24 V) errónea			
004	Bit1 = 1 : L2+ (24 V) errónea			
201	¡No se usa!			
202				
203				
300	Comparador de subtensión de 24 V (BOOL)			
10011032	Estado de los o			
	Codificación	Descripción		
	0x0001	Se ha producido un error de la unidad de hardware (submódulo)		
	0x0002	Error de canal debido a error interno		
	0x1000	Error de enlace de bus de E/S A		
	0x2000	Error de enlace de bus de E/S B		
	0x4000	Error de canal en la prueba de la conexión de entrada digital A		
	0x8000	Error de canal en la prueba de la conexión de entrada digital B		
20012008	Estado de erro	r de las fuentes de alimentación 18 (alimentaciones)		
	Codificación	Descripción		
	0x0001	Error de módulo		
	0x8000	Subtensión en las alimentaciones		

Tabla 22: Diagnostic Information [DWORD]

Página 38 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

4.5 Variantes de conexión

Este capítulo describe el correcto circuitado de seguridad instrumentada del módulo. Son admisibles las siguientes variantes de conexión.

4.5.1 Puestas en circuito de las entradas

Las entradas se conectan al circuito mediante tarjetas de conexión. Para una redundante puesta en circuito se dispone de tarjetas de conexión especiales.

La alimentación está desacoplada mediante diodos, de forma que, en caso de aplicar la redundancia de módulo, las alimentaciones de dos módulos pueden alimentar a un iniciador.

En las puestas en circuito como la de la Fig. 12, Fig. 13, Fig. 14 y Fig. 15, podrán usarse las tarjetas de conexión X-CB 015 01 (con bornes de rosca) o X-CB 015 03 (con conector de cables).

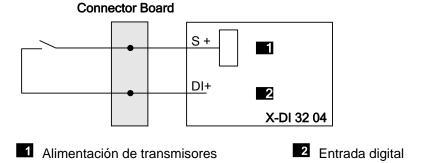


Fig. 12: Puesta en circuito con contactor o iniciador a 2 hilos

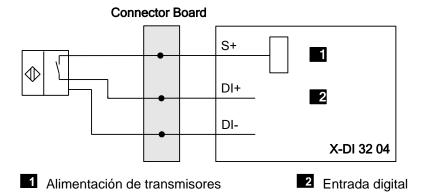


Fig. 13: Puesta en circuito con iniciador a 3 hilos

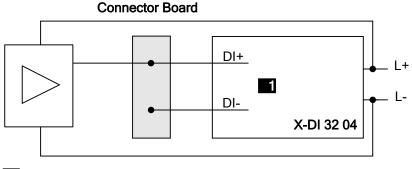
HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 39 de 54

Connector Board DI+ DIX-DI 32 04

Entrada digital

Fig. 14: Puesta en circuito de una fuente de señal digital con alimentación galvánicamente separada

Si se aplica al módulo de entrada una fuente de señal digital con alimentación no separada galvánicamente, conecte la masa de la fuente de señal a la L- del sistema HIMax.



1 Entrada digital

Fig. 15: Puesta en circuito de una fuente de señal digital con alimentación no separada galvánicamente

NOTA



¡Sobreintensidad por conexión incorrecta del circuito!

La inobservancia puede dar lugar a daños en elementos electrónicos.

No conecte la masa de una fuente de señal digital con alimentación no separada galvánicamente a la DI- del módulo de entrada.

Página 40 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

En las puestas en circuito redundantes como la de la Fig. 16, Fig. 17 y la de la Fig. 18, los módulos de entrada están conectados adyacentemente en el rack en una tarjeta de conexión común.

Podrán usarse las tarjetas de conexión X-CB 015 02 (con bornes de rosca) o X-CB 015 04 (con conector de cables).

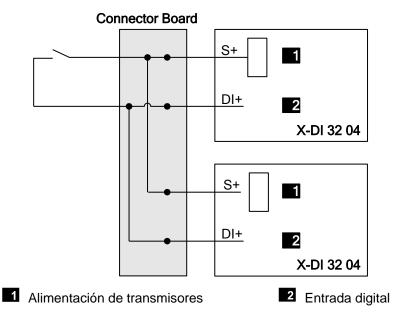


Fig. 16: Puesta en circuito redundante con contactor o iniciador a 2 hilos

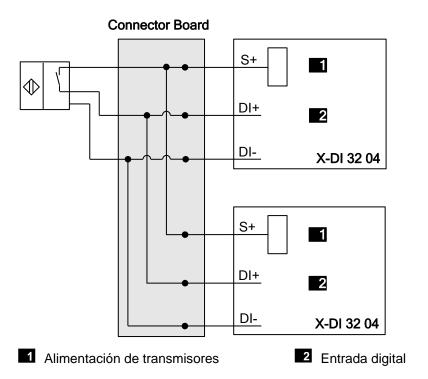
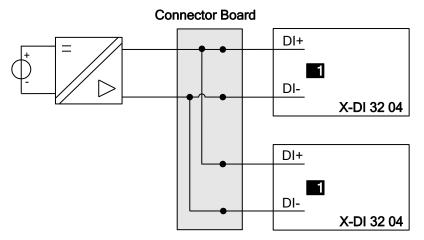


Fig. 17: Puesta en circuito redundante con iniciador a 3 hilos

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 41 de 54



1 Entrada digital

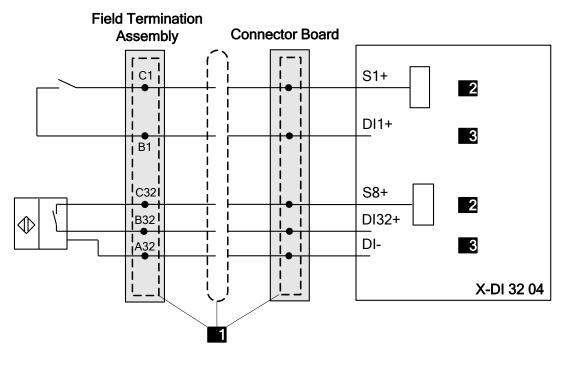
Fig. 18: Puesta en circuito redundante de una fuente de señal digital con alimentación galvánicamente separada

Página 42 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

4.5.2 Conexión de transmisores mediante terminaciones FTA (Field Termination Assembly)

La conexión de contactores y transmisores mediante el bloque de terminación de campo X-FTA 001 01 se realiza como se ilustra en la Fig. 19. Hallará más información en "X-FTA 001 01" en el manual HI 801 227 ES.

Se usa la tarjeta de conexión X-CB 015 03.



- Cable de sistema con conector de cables
 - 3 Entrada digital
- 2 Alimentación de transmisores

Fig. 19: Conexión mediante terminación FTA (Field Termination Assembly)

4.5.3 Protección de Ex con barreras Zener

Para la protección de explosiones pueden usarse barreras Zener, p. ej. barreras MTL del tipo 7787+ o Pepperl+Fuchs del tipo Z787.

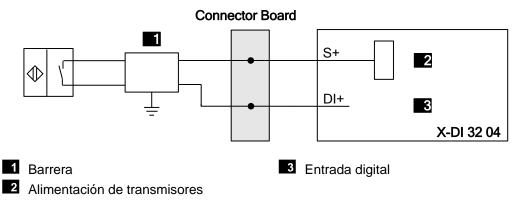


Fig. 20: Conexión monocanal de iniciadores con barrera

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 43 de 54

4.5.4 Protección de Ex con amplificador de separación

Para la protección de explosión pueden usarse amplificadores de separación, como p. ej. los amplificadores de separación H 4011 y H 4012 de HIMA. Si en el circuito se incluye un separador de alimentación, no se usará la alimentación de los iniciadores.

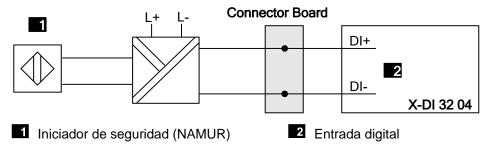


Fig. 21: Conexión monocanal de un amplificador de separación

Página 44 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

X-DI 32 04 5 Funcionamiento

5 Funcionamiento

El módulo opera en un rack HIMax y no necesita de monitoreo especial.

5.1 Manejo

No se contempla ninguna operación de manejo en el módulo en sí.

Operaciones como p. ej. el forzado de las entradas digitales se realizan en el PADT. Hallará más información al respecto en la documentación de SILworX.

5.2 Diagnóstico

El estado del módulo se indica mediante LEDs en la cara frontal del módulo. Véase el capítulo 3.4.2.

El historial de diagnóstico del módulo puede además leerse con la utilidad de programación SILworX. En los capítulos 4.4.4 y 4.4.5 se describen los estados de diagnóstico más importantes.

Si en un rack se encaja un módulo, éste generará mensajes de diagnóstico durante la inicialización, los cuales apuntarán a disfunciones tales como valores de tensión incorrectos.

Estos mensajes denotarán un error del módulo sólo cuando se produzcan tras la transición al estado de sistema en funcionamiento.

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 45 de 54

6 Mantenimiento X-DI 32 04

6 Mantenimiento

Los módulos averiados deberán sustituirse con módulos intactos del mismo tipo o de un tipo de reemplazo homologado.

La reparación del módulo está reservada al fabricante.

Para sustituir módulos deberán observarse las condiciones indicadas en el manual del sistema HI 801 141 ES y el manual de seguridad HI 801 196 ES.

6.1 Tareas de mantenimiento

6.1.1 Carga del sistema operativo

En el marco del mantenimiento perfectivo, HIMA sigue desarrollando el sistema operativo del módulo. HIMA recomienda aprovechar paradas programadas de la línea para cargar la versión actual del sistema operativo a los módulos.

La carga del sistema operativo se describe en el manual del sistema y en la ayuda directa en pantalla. Para cargar el sistema operativo, el módulo deberá encontrarse en estado STOP.

La versión actual del módulo figura en el panel de control de SILworX. La placa de tipo indica la versión instalada a la entrega de fábrica, véase el capítulo 3.3.

6.1.2 Ensayo de prueba

Los módulos HIMax deben someterse a un ensayo de prueba cada 10 años. Hallará más información en el manual de seguridad HI 801 196 ES.

Página 46 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

7 Puesta fuera de servicio

Saque el módulo del rack para ponerlo fuera de servicio. Más información en el capítulo *Instalación y desmontaje del módulo*.

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 47 de 54

8 Transporte X-DI 32 04

8 Transporte

Para evitar daños mecánicos, transporte los componentes HIMax empaquetados.

Guarde los componentes HIMax siempre empaquetados en su embalaje original. Éste sirve además como protección contra descargas ES. El embalaje del producto solo no es suficiente para el transporte.

Página 48 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

X-DI 32 04 9 Desecho

9 Desecho

Los clientes industriales son responsables de desechar ellos mismos el hardware de HIMax tras la vida útil del mismo. Si se desea puede solicitarse a HIMA la eliminación de los componentes usados.

Deseche todos los materiales respetuosamente con el medio ambiente.

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 49 de 54

Anexo X-DI 32 04

Anexo

Glosario

Término	Descripción
ARP	Address Resolution Protocol: protocolo de red para asignar direcciones
	de red a direcciones de hardware
Al	Analog input: entrada analógica
Connector Board	Tarjeta de conexión para módulo HIMax
COM	Módulo de comunicación
CRC	Cyclic Redundancy Check: suma de verificación
DI	Digital input: entrada digital
DO	Digital output: salida digital
CEM	Compatibilidad electromagnética
EN	Normas europeas
ESD	ElectroStatic Discharge: descarga electrostática
FB	Bus de campo
FBS	Lenguaje de bloques funcionales
FTT	Tiempo de tolerancia de errores
ICMP	Internet Control Message Protocol: protocolo de red para mensajes de estado
	y de error
IEC	Normas internacionales de electrotecnia
Dirección MAC	Dirección de hardware de una conexión de red (Media Access Control)
PADT	Programming and Debugging Tool (según IEC 61131-3), PC con SILworX
PE	Tierra de protección
PELV	Protective Extra Low Voltage: baja tensión funcional con separación segura
PES	Programmable Electronic System
PFD	Probability of Failure on Demand: probabilidad de un fallo al solicitar una función de seguridad
PFH	Probability of Failure per Hour: probabilidad de una disfunción peligrosa por hora
R	Read
ID de Rack	Identificación (número) de un rack
Sin repercusiones	Suponiendo que hay dos circuitos de entrada conectados a la misma fuente (p. ej. transmisor). Entonces un circuito de entrada se denominará "sin repercusiones", cuando no falsee las señales del otro circuito de entrada.
R/W	Read/Write
SB	Bus de sistema (módulo de bus)
SELV	Safety Extra Low Voltage: baja tensión de protección
SFF	Safe Failure Fraction: porcentaje de fallos fácilmente dominables
SIL	Safety Integrity Level (según IEC 61508)
SILworX	Utilidad de programación para HIMax
SNTP	Simple Network Time Protocol (RFC 1769)
SRS	Direccionamiento por "Sistema.Rack.Slot" de un módulo
SW	Software
TMO	TimeOut
TMR	Triple Module Redundancy: módulos de triple redundancia
W	Write
W _S	Valor máximo del total de componentes de corriente alterna
WatchDog (WD)	Control de tiempo para módulos o programas. En caso de excederse el tiempo de WatchDog, el módulo pasará al estado de parada con fallo.
WDT	WatchDog Time
1101	Tracino g Time

Página 50 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

X-DI 32 04 Anexo

Índice de	e ilustraciones	
Fig. 1:	Ejemplo de placa de tipo	11
Fig. 2:	Diagrama de bloques	12
Fig. 3:	Lectura	13
Fig. 4:	Vistas	16
Fig. 5:	Ejemplo de una codificación	19
Fig. 6:	Tarjetas de conexión X-CB 015 con bornes de rosca	20
Fig. 7:	Tarjetas de conexión X-CB 015 con conector de cables	23
Fig. 8:	Cable de sistema X-CA 001 01 n	25
Fig. 9:	Colocación de la tarjeta de conexión	28
Fig. 10:	Atornillado de la tarjeta de conexión	29
Fig. 11:	Instalación y desmontaje de módulo	31
Fig. 12:	Puesta en circuito con contactor o iniciador a 2 hilos	39
Fig. 13:	Puesta en circuito con iniciador a 3 hilos	39
Fig. 14:	Puesta en circuito de una fuente de señal digital con alimentación galvánicamente separada	40
Fig. 15:	Puesta en circuito de una fuente de señal digital con alimentación no separada galvánicamente	40
Fig. 16:	Puesta en circuito redundante con contactor o iniciador a 2 hilos	41
Fig. 17:	Puesta en circuito redundante con iniciador a 3 hilos	41
Fig. 18:	Puesta en circuito redundante de una fuente de señal digital con alimentación galvánicamente separada	42
Fig. 19:	Conexión mediante terminación FTA (Field Termination Assembly)	43
Fig. 20:	Conexión monocanal de iniciadores con barrera	43
Fig. 21:	Conexión monocanal de un amplificador de separación	44

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 51 de 54

Anexo X-DI 32 04

Índice de	tablas	
Tabla 1:	Manuales vigentes adicionales	5
Tabla 2:	Condiciones ambientales	8
Tabla 3:	Frecuencias de parpadeo de los LED	14
Tabla 4:	Indicadores de estado de módulo	14
Tabla 5:	Indicadores de bus de sistema	15
Tabla 6:	LED indicadores de E/S	15
Tabla 7:	Datos del producto	16
Tabla 8:	Datos técnicos de las entradas digitales	17
Tabla 9:	Datos técnicos de alimentación	17
Tabla 10:	Tarjetas de conexión disponibles	18
Tabla 11:	Posición de las cuñas de codificación	19
Tabla 12:	Asignación de bornes de tarjetas de conexión con bornes de rosca	21
Tabla 13:	Características de los conectores de bornes	22
Tabla 14:	Asignación de conectores de tarjetas de conexión con conector de cables	24
Tabla 15:	Datos de cables	25
Tabla 16:	Cables de sistema disponibles	25
Tabla 17:	Descripción de eventos	32
Tabla 18:	Ficha Module del editor de hardware	34
Tabla 19:	Ficha I/O Submodule DI32_04 del editor de hardware	35
Tabla 20:	Ficha I/O Submodule D32_04: Canales en el editor de hardware	36
Tabla 21:	Submodule Status [DWORD]	37
Tabla 22:	Diagnostic Information [DWORD]	38

Página 52 de 54 HI 801 213 ES Rev. 4.00

X-DI 32 04 Anexo

Índice alfabético

Datos técnicos	Diagrama de bloques	12
Alimentación de iniciadores17	Función de seguridad	10
Entradas17	Indicadores de estado de módulo	14
Módulo 16	Tarjeta de conexión	18
Diagnóstico45	Con bornes de rosca	20
Indicadores de bus de sistema15		
Indicadores de E/S15	de cables	23

HI 801 213 ES Rev. 4.00 Página 53 de 54



HI 801 213 ES © 2015 HIMA Paul Hildebrandt GmbH HIMax y SILworX son marcas registradas de: HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Albert-Bassermann-Str. 28 68782 Brühl, Alemania Tel. +49 6202 709-0 Fax +49 6202 709-107 HIMax-info@hima.com www.hima.com



